



Skytech 天虹科技 **6937**
上市前業績發表會

主辦承銷商  **元大證券**
Yuanta Securities

一、產業風險

- 客戶對國產設備信心不足

二、營運風險

- 尖端人才的取得及留任
- 智慧財產權的保護與創新

三、其他重要風險

- 本公司其他重要風險請詳本公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

補充揭露事項

依據臺灣證券交易所股份有限公司112年10月4日臺證上一字第1121804749 號函，補充揭露事項如下：

(一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

- (1) 最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。
- (2) 銷貨集中之緣由、所面臨風險暨因應措施。

(二)於公開說明書增加公司智慧財產權系統導入情形暨具體保護措施。

相關說明請參閱公開資訊觀測站之現金增資發行新股公開說明書

免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。

天虹科技股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

- 01 天虹科技簡介
- 02 主要產品及競爭優勢
- 03 經營實績
- 04 未來展望
- 05 公司治理及企業社會責任

01 天虹科技簡介

02 主要產品及競爭
優勢

03 經營實績

04 未來展望

05 公司治理及企業
會責任

經營團隊背景

- 黃見駱: 天虹科技董事長兼總經理
- 羅偉瑞: 集團創辦人; 天虹科技執行副總經理
- 易錦良: 集團執行長 (前美商應用材料公司全球副總裁)



黃見駱



羅偉瑞



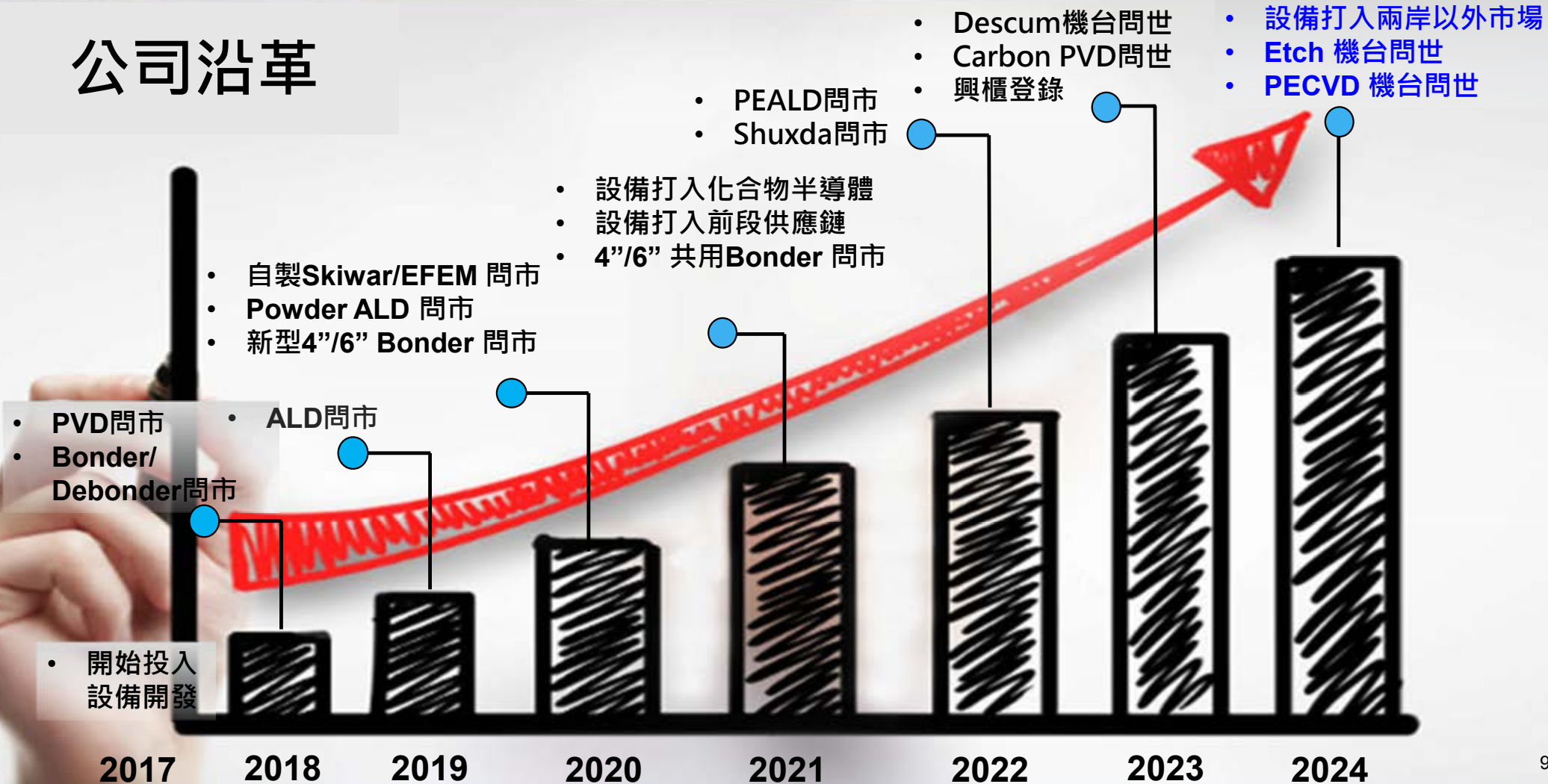
易錦良

天虹科技簡介-概覽(1/2)

- 創立時間：2002年
- 資本額：新臺幣6.07億
- 股票興櫃時間：2023年1月6日
- 董事長兼總經理：黃見駱
- 集團執行長：易錦良
- 員工人數：353人

天虹科技簡介-概覽(2/2)

公司沿革



天虹科技 - 營業據點



天虹科技 - 湖口廠 & 無塵室



萬級組裝區



千級實驗區



01 天虹科技簡介

02 主要產品及競爭
優勢

03 經營實績

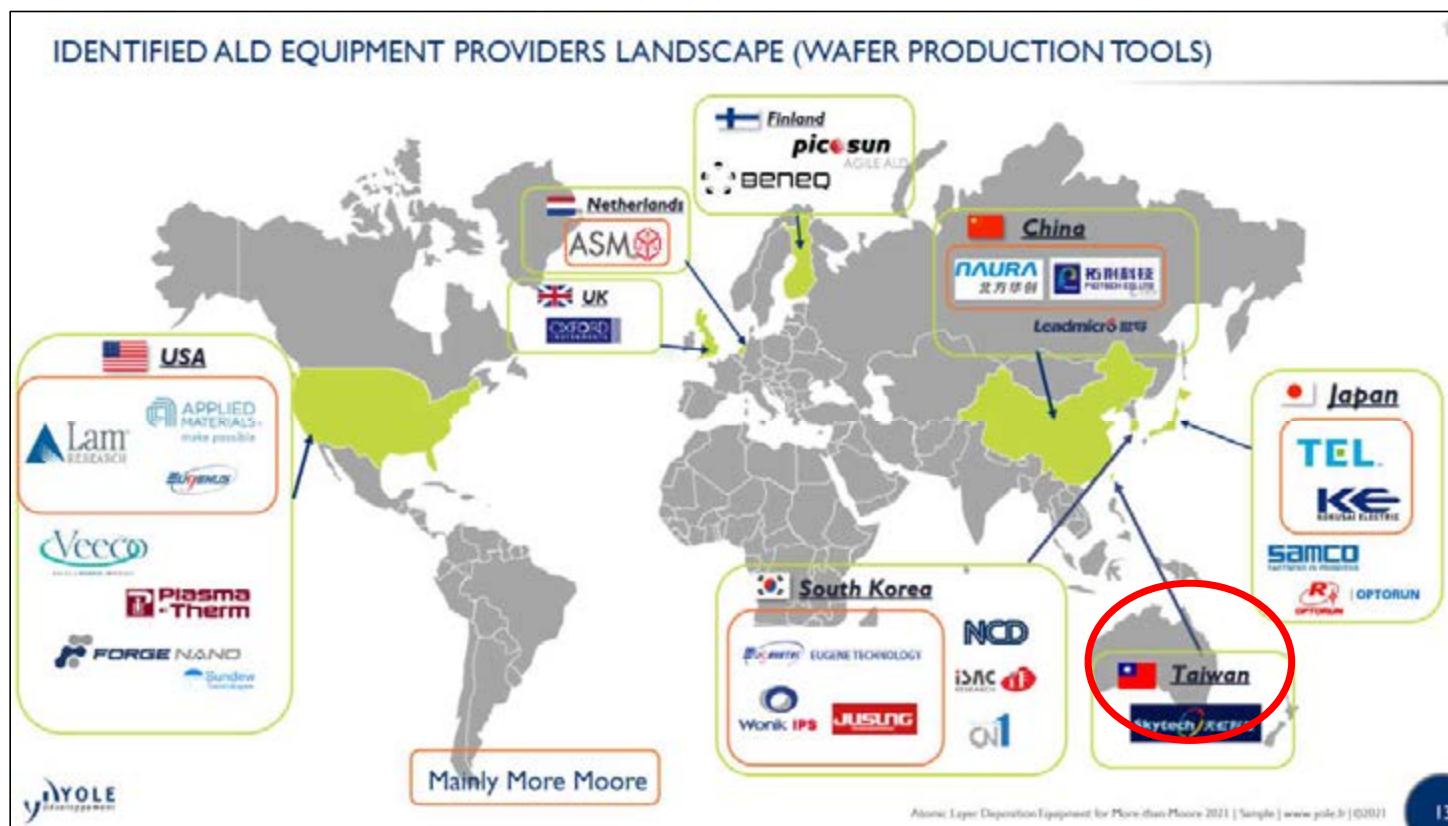
04 未來展望

05 公司治理及企業
社會責任

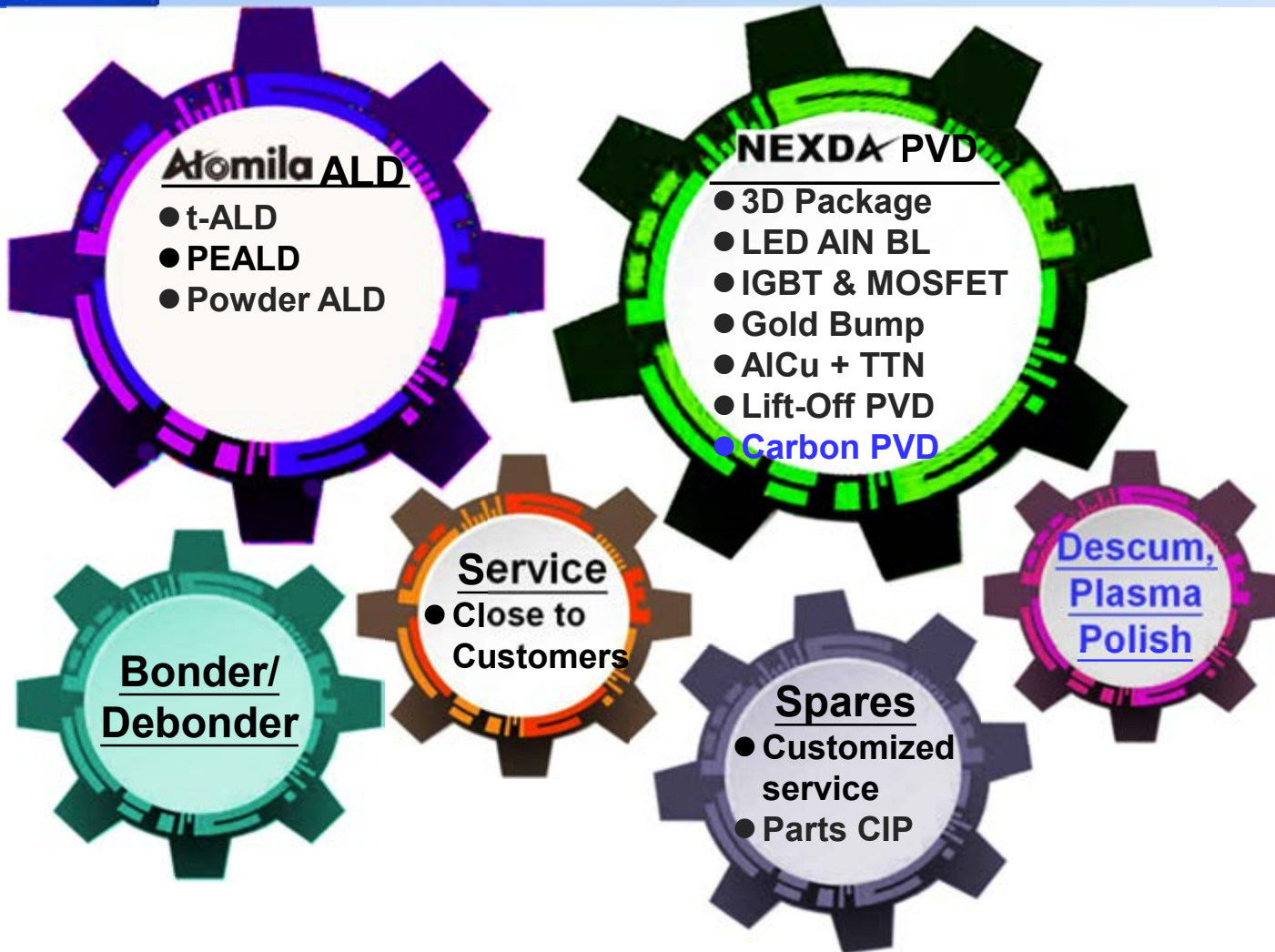
天虹科技競爭優勢

天虹科技躋身全球ALD設備供應商

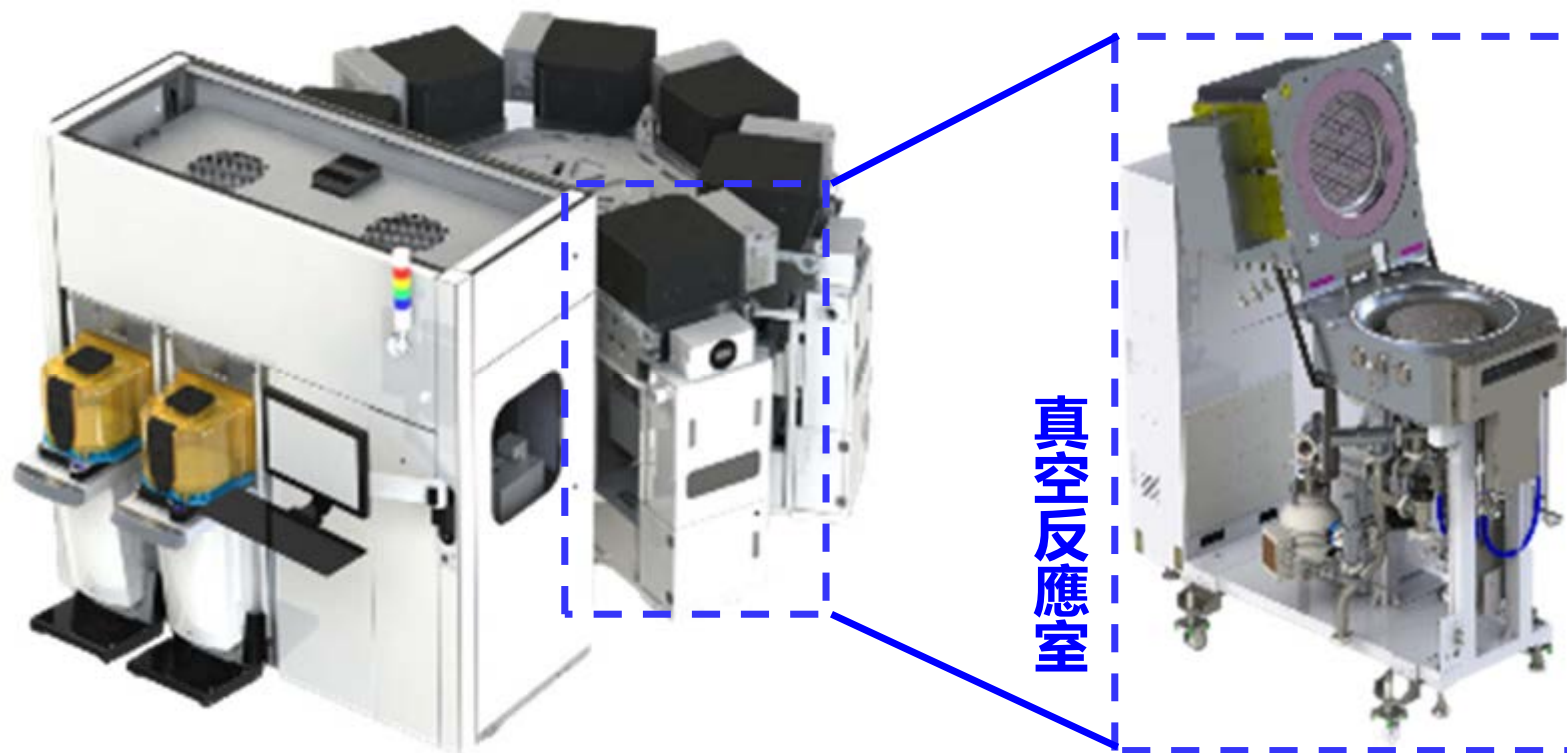
法國知名半導體及電子元件研究機構Yole Développement針對ALD的報告中，已將天虹列為世界主流的ALD設備供應商。



天虹科技-主要產品



零備件 - 真空反應室內耗材類



零備件 - 真空反應室內耗材類

波紋管 (Bellows) : **73** 項



陶瓷類 : **224** 項



磁流體 (Magnet Seal) : **79** 項



金屬類及氣體均流器 : **705** 項
(Shower Head)



工程塑膠類 : **310** 項



石英類 : **42** 項



零備件 - 維修/功能改善

晶圓傳送類 : **23** 項



真空電漿反應室晶圓承載盤 : **43** 項
(控溫、靜電吸附、電漿極):



真空閥件類 (Valve) : **179** 項



電漿源系統 : **25** 項



電子系統 : **81** 項



零備件 - 客製設計產品

設備及晶圓監控系統：**22** 項



設備備份系統：**171** 項



晶圓良率改善系統：**16** 項



中古設備移裝、裝機、翻新、改裝服務

主要服務產品：PVD, CVD, Etch, RTP, Wet, Metrology..... : **39**種設備



改裝



移機

TOTAL SOLUTION



翻新



裝機

天虹製程設備家族

Lift-Off
PVD

LED AlN
Buffer
Layer

IGBT &
MOSFET

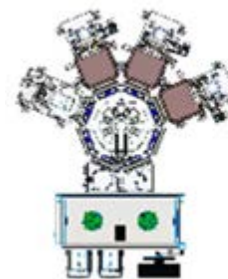
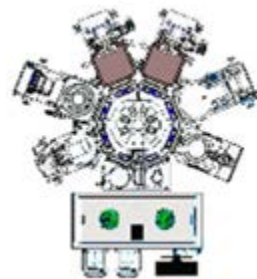
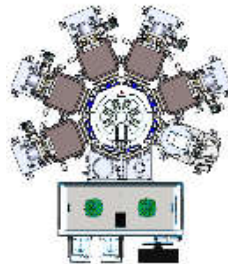
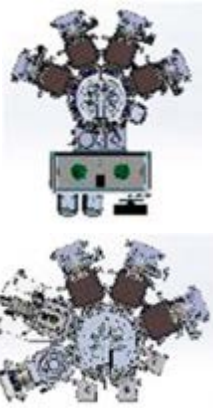
FEOL
(AlCu +
TTN)

Advanced
Package

Gold Bump
/ Bumping

t-ALD +
Pre-treatment

PEALD
NBT/C²PT



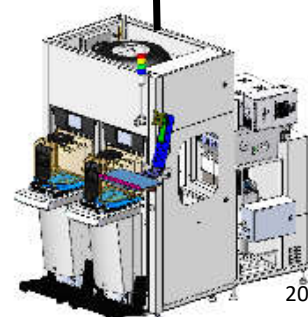
Bonder

De-
Bonder

Skiwar

Powder
t-ALD Al₂O₃

Descum/
Plasma Polish



Core Competence & RD Direction

High Vacuum Plasma & Wafer Thinning Solution Provider



High Vacuum & Plasma



Descum & Plasma Polish



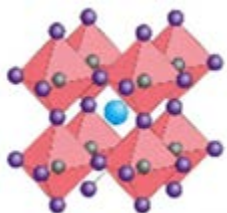
PVD



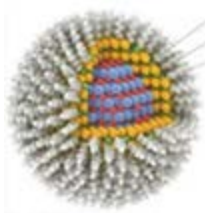
Powder ALD (for QD)



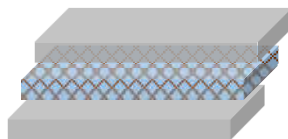
ALD



Perovskite QD



CdSe QD



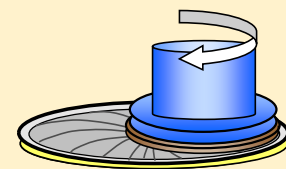
QD film/ QD Glass

Silicon Semiconductor
Frontend/Adv. Package/IGBT BM
(PVD, ALD, Bonder, Descum)

Compound Semiconductor
GaAs/InP/SiC/GaN
(PVD, ALD, Bonder, De-bonder,
Plasma Polish)

LED/Mini LED/ Micro LED
(PVD, ALD, Powder ALD) & (QD solution)

CPO (Co-Package Optics)
(PVD)



Wafer Thinning



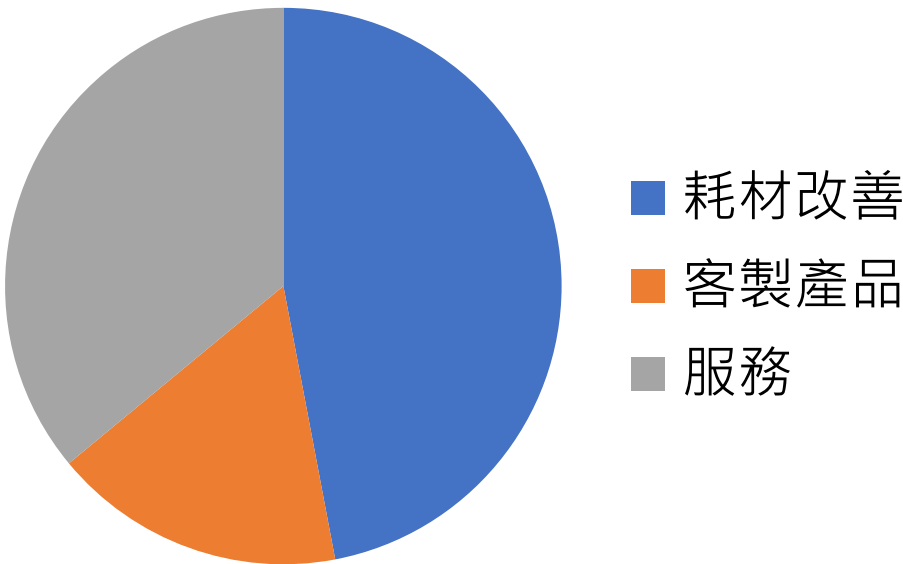
Bonder



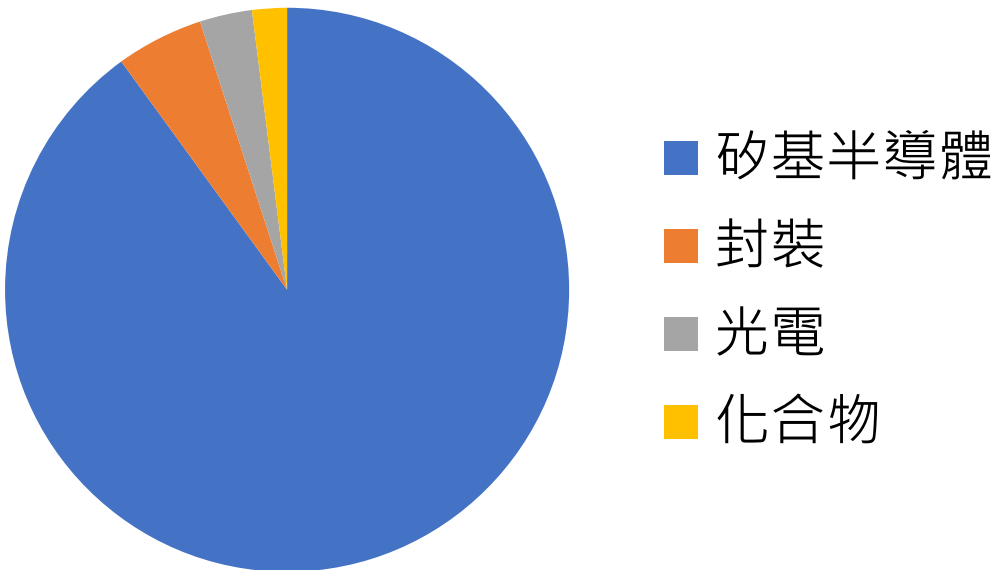
De-Bonder

天虹科技零組件產品及產業分布

零組件產品概分類

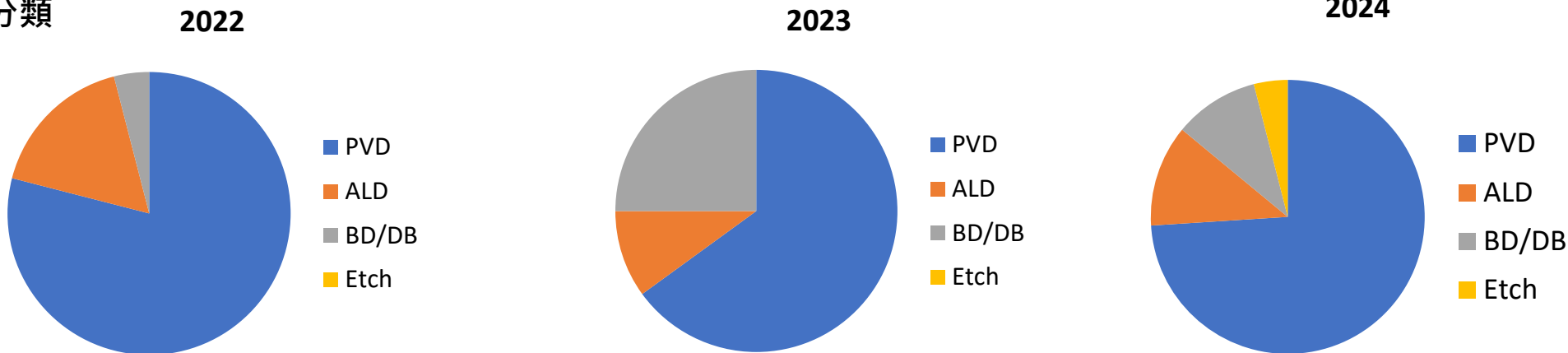


零組件產業分布

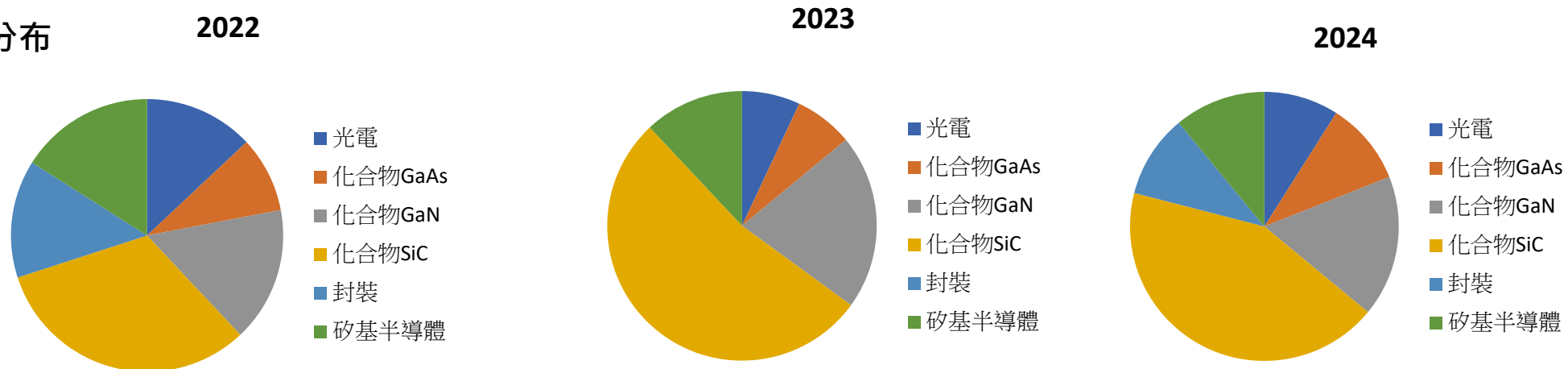


天虹科技設備產品及產業分布

設備產品分類



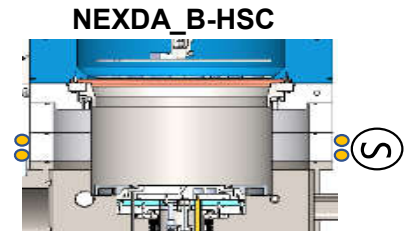
設備產業分布



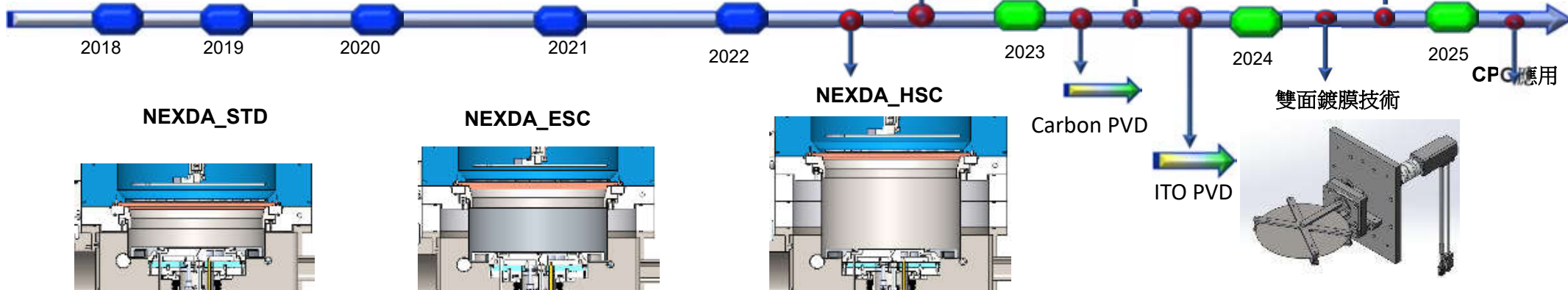
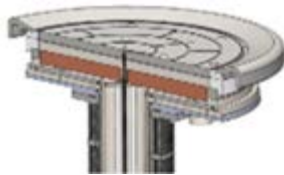
Roadmap of PVD

NEXDA

- ESC: Enhanced Step Coverage
- HSC: High Step Coverage
- B-HSC: Bias High Step Coverage

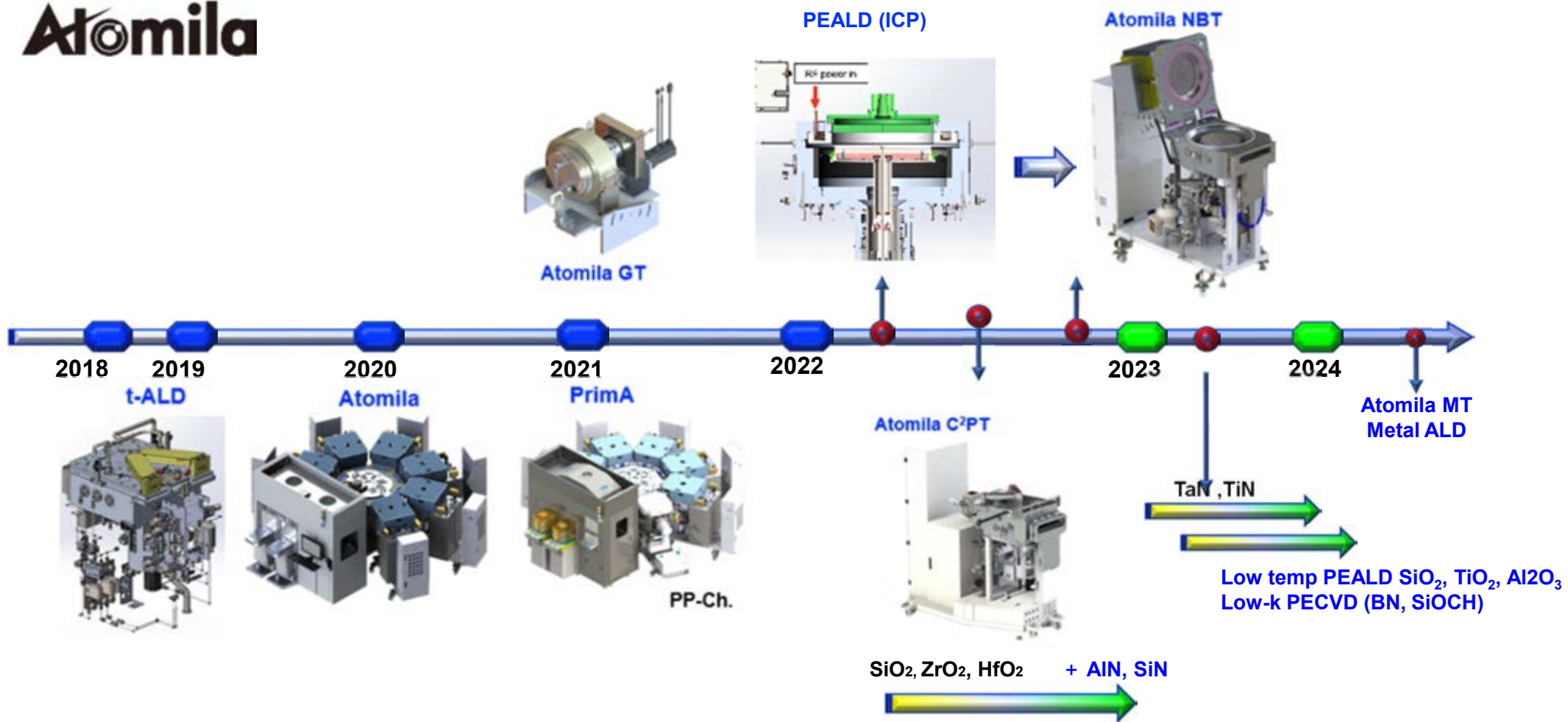


AlN Heater



Roadmap of ALD

Atomila



Roadmap of Bonder & Debonder

CatapultA



BondelA



- 研發高精度Bonder (for 3DIC hybrid bond)



- 8"、12" Bonder (For wafer thinning)

- 4"/6" 共用Bonder

- 自動分離減薄wafer和透氣吸盤



Roadmap of Descum & Plasma Polish

Descum

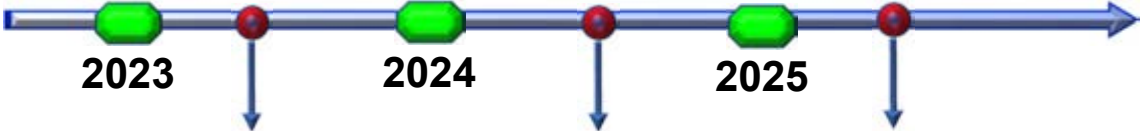


Plasma Polish & Dry etching



Integrated with Std. EFEM

Integrated with Narrow Body LL



- Descum & Dry etching for 3DIC related application :**
- PI & PR descum
 - LTHC dry etching

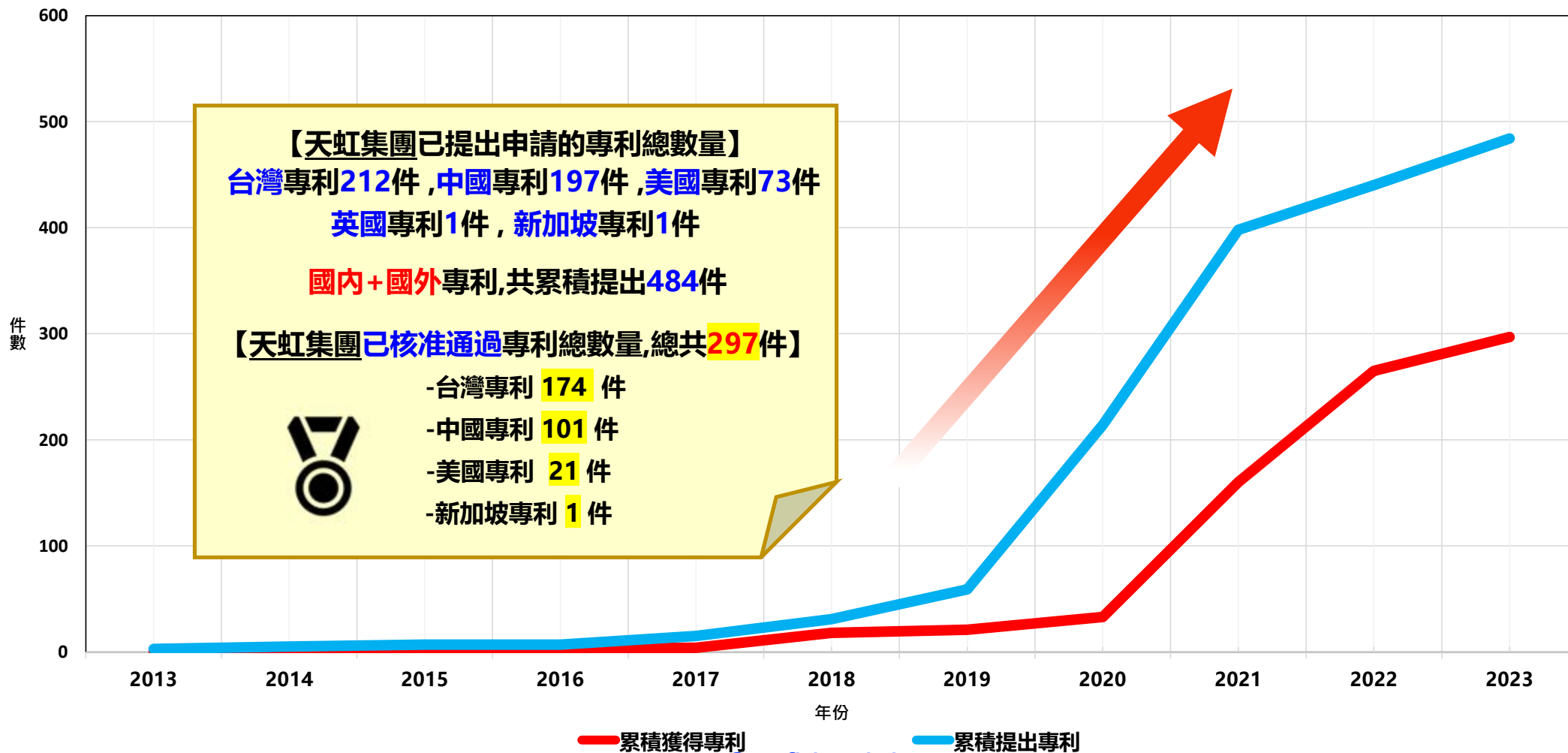
SiC Plasma Polish

- Dry etching for SiC MOSFET**
- SiC MOSFET backside etching
 - SiC trench gate formation

- Atomic layer etching (ALE) for p-GaN HEMT**
- Low damage AlGaN Etching

國內外專利件數統計

(統計至2023.10.02)



Confidential

競爭優勢 - ISO & Semi S2 Certification



ISO 認證



PVD Semi S2 認證



ALD Semi S2 認證



Auto Debonder Semi S2 認證



Auto Bonder Semi S2 認證

01

天虹科技簡介

02

主要產品及競爭
優勢

03

經營實績

04

未來展望

05

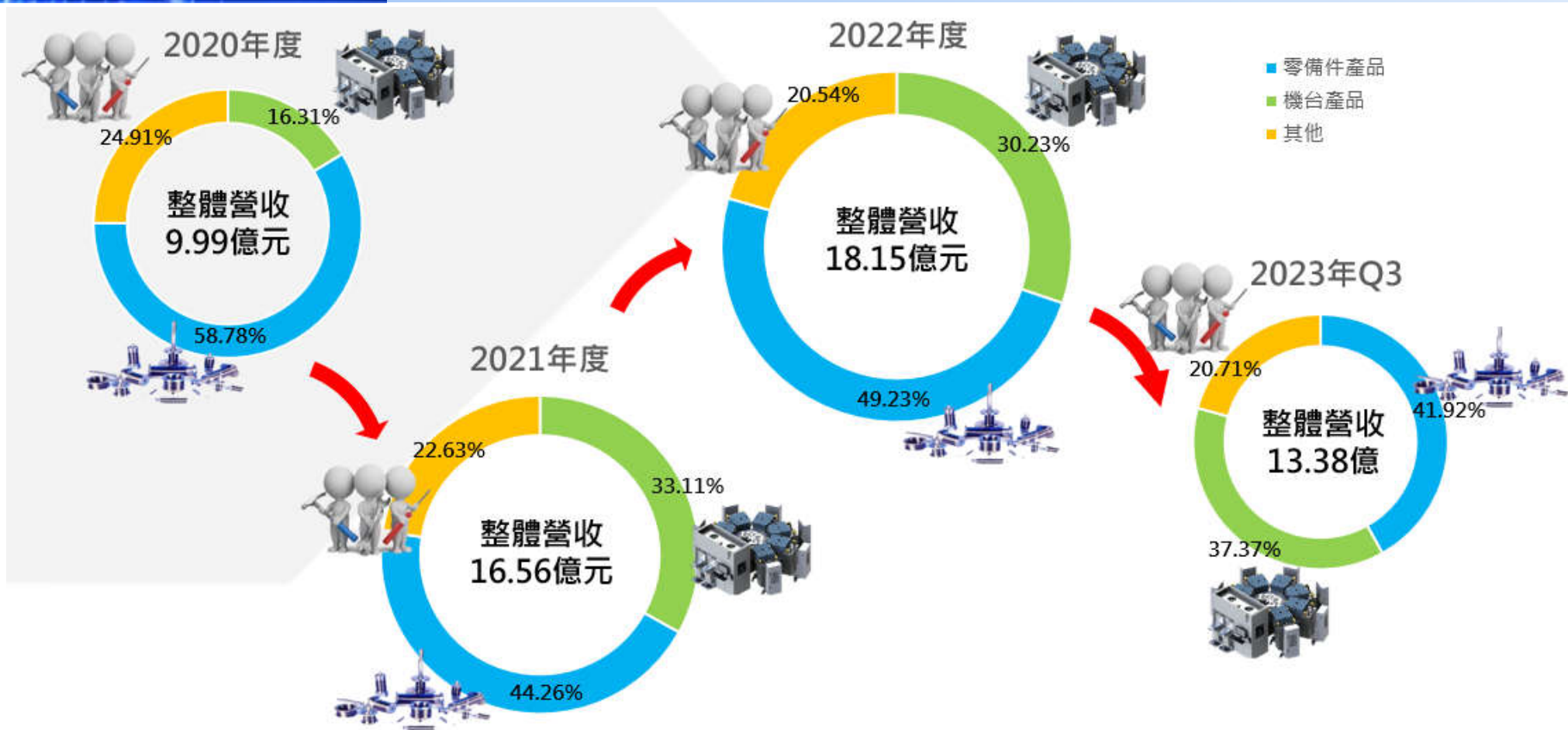
公司治理及企業
社會責任

近期合併財務數據

單位：新臺幣千元；每股盈餘為新臺幣元；%

項目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年前三季
營業收入	998,574	1,655,712	1,815,477	1,337,551
營業毛利	390,197	662,528	845,972	565,228
毛利率	39.08%	40.01%	46.60%	42.26%
營業費用	381,474	471,843	557,629	402,470
稅前淨利	77,090	241,538	366,469	197,197
稅後淨利	61,787	224,620	316,862	159,150
每股盈餘	1.63	4.57	5.66	2.62

天虹科技產品營收比重



01

天虹科技簡介

02

主要產品及競爭
優勢

03

經營實績

04

未來展望

05

公司治理及企業
社會責任

未來展望-Organic & Inorganic 成長計畫

■ Organic 成長計畫

- 設備打進各領域領先企業，藉由這成績開拓國際市場
- 除了持續開發PVD/ALD/Bonder/Debonder下一世代的設計，藉由Descum設備的開發 (2023)，打入Etch的市場 (2024)。並藉由PEALD設備的開發 (2022)，開發PECVD機台 (2024)。

■ Inorganic 成長計畫

- 藉由量子點(QD)開發，跨足材料的市場
 - QD film，QD Glass & QD-LED - 2023
 - QD-IJP & QD-PR for micro LED - 2024
- IPO後啟動併購，目標現有或潛在設備and/or材料供應商

01

天虹科技簡介

02

主要產品及競爭
優勢

03

經營實績

04

未來展望

05

公司治理及企業
社會責任

公司願景

1 強化公司治理，建立永續經營制度。

2 吸引優秀人才加入，提升研發量能。

3 增加籌資管道，擴大營運規模。

4 深化台灣半導體設備品牌，帶動產業技術提升。

公司治理與企業社會責任

透明資訊揭露

即時營運資訊揭露，確保股東權益。

公司與利害關係人溝通

公司網站設置利害關係人專區以建立與投資人良好之溝通管道。

公司之誠信經營政策

訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「防範內線交易管理作業辦法」，並定期檢討修正。

公司所辨認之環境風險

本公司依重大性原則不定期評估外部因素及公司內部管理是否就外在環境、社會及內部公司治理等議題進行風險評估，訂定「永續發展實務守則」等相關辦法。

供應商對環境與社會造成之衝擊評估

本公司訂定「供應商管理辦法」、「永續發展實務守則」及「誠信經營守則」，不僅規範公司內部人員，亦包含公司往來供應商等企業或個人遵守規定。

人事及員工福利制度

公司每年實施員工健康檢查、員工團險、員工旅遊、員工聚餐等，且公司訂有「工作規則」、「員工福利辦法」、「勞工退休辦法」等辦法，並定期檢討修正。

企業社會責任



合作院校
2所



實習生
34人次





Skytech 天虹科技

Atomila Bondela Catapulta NEXDA Shuxda



Skytech 天虹科技 **6937**
上市前業績發表會

主辦承銷商  **元大證券**
Yuanta Securities